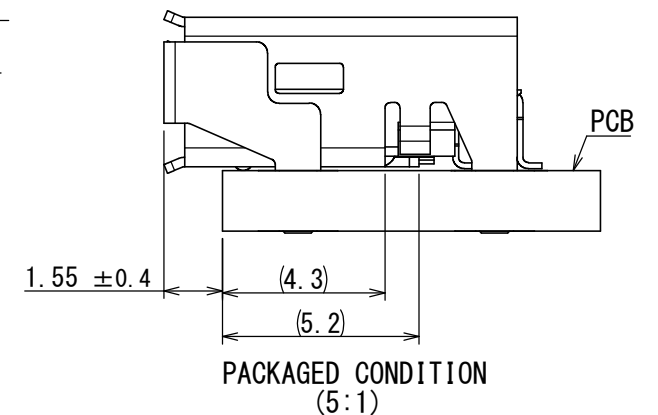
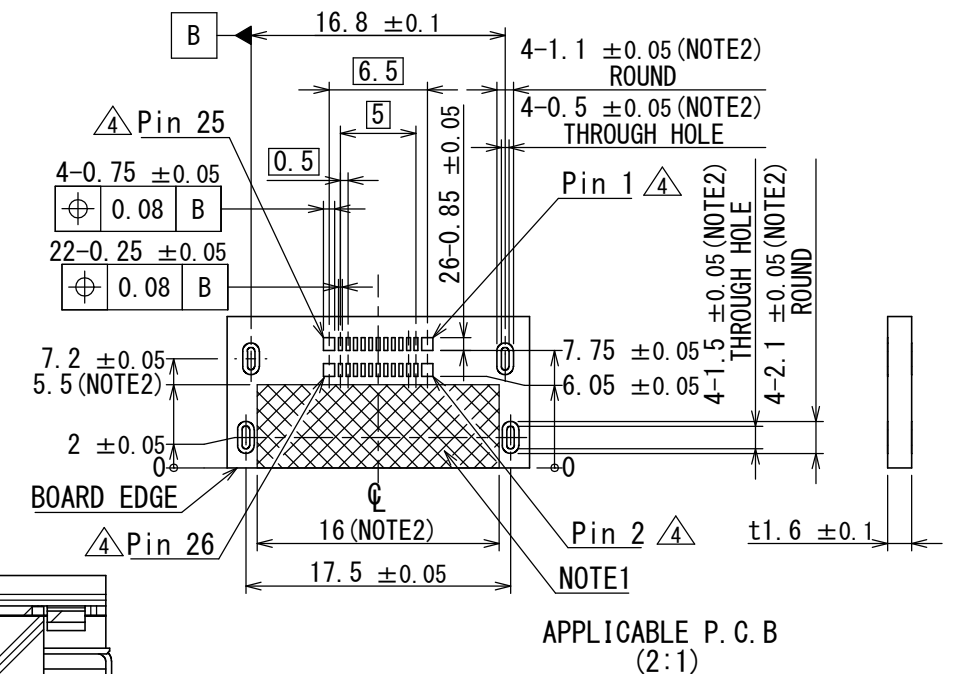
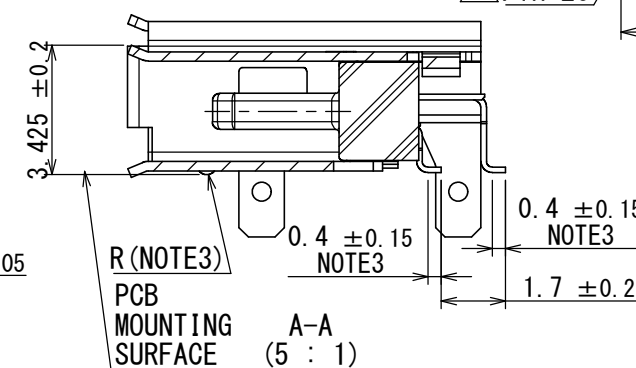
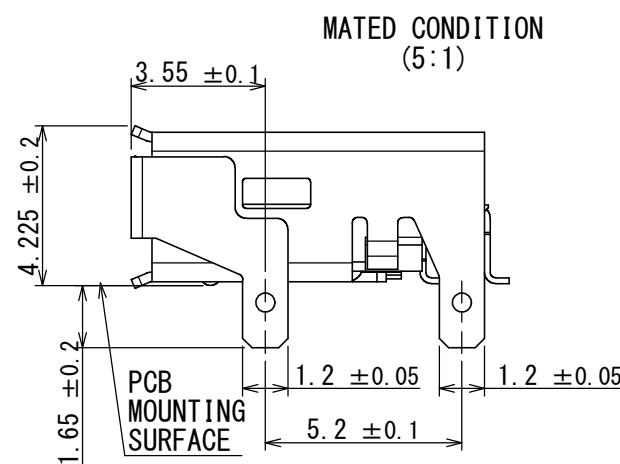
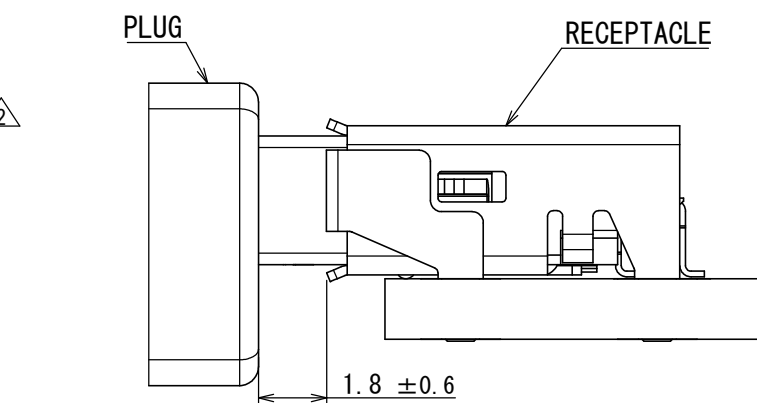
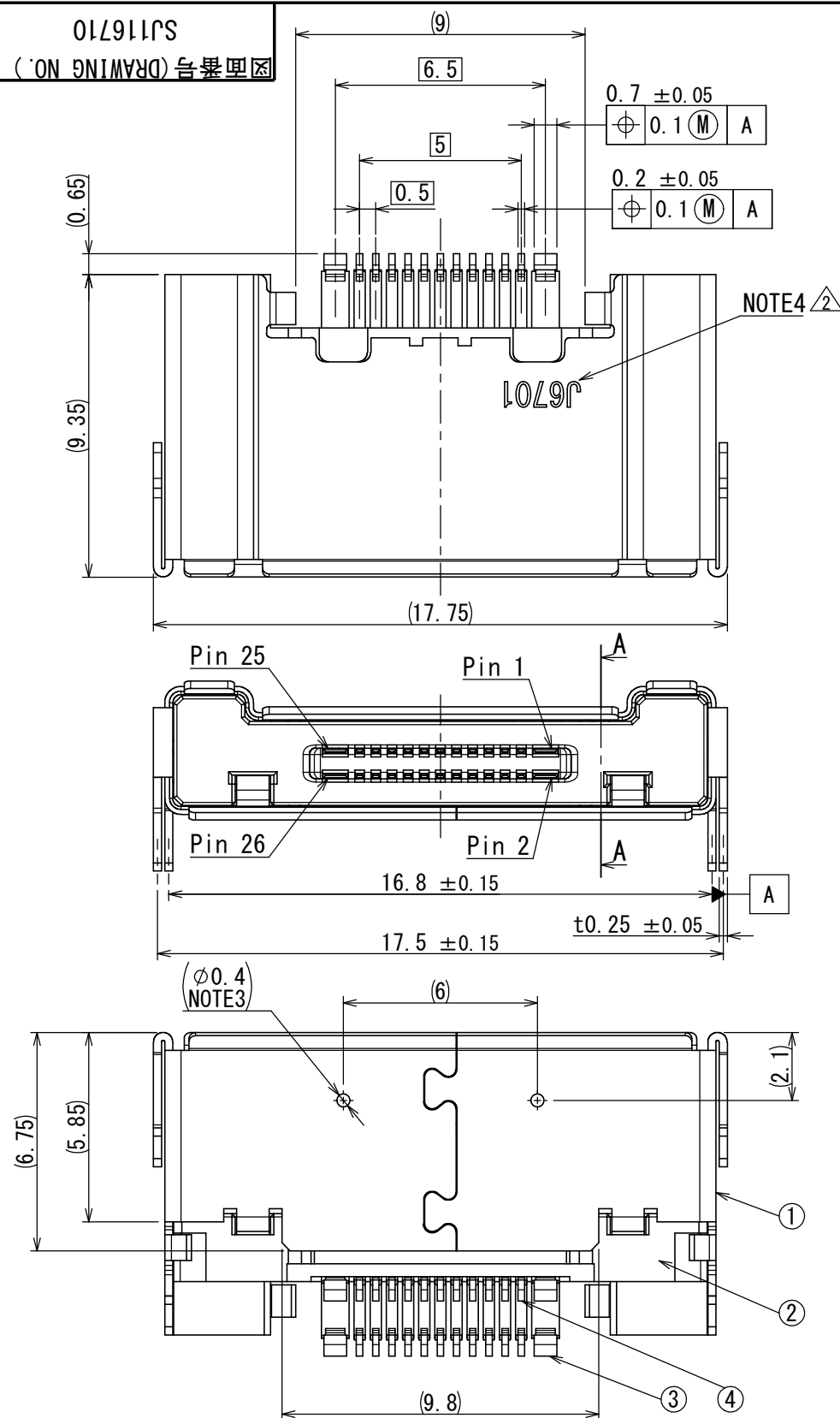


版数 VER.	年月日 D A T E	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	10/MAY/2016	017343	ADDED LOT NUMBER	N. IKENAGA	N. IKENAGA	—	S. HIRAYAMA
3	06/JUL/2016	018059	DELETE PIN DEFINITION etc.	N. IKENAGA	N. IKENAGA	—	T. KUDOU
4	29/MAY/2018	025335	ADDED PIN NUMBER	N. IKENAGA	N. IKENAGA	—	T. KUDOU



4	SIG CONTACT	22	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD OVER NICKEL	CONTACT AREA: GOLD:0.1 μ m MIN.
3	PWR CONTACT	4	COPPER ALLOY	SOLDER TAILS: GOLD FLASH OVER NICKEL	SOLDER TAILS: GOLD FLASH:0.03 μ m MIN.
2	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	—
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY	—
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

NOTE1.NO PCB ROUTING ALLOWED IN THIS AREA.
NOTE2.LAND MARK BOTH SIDES OF P.C.B. HOLE IS THROUGH HOLE PLATED.
NOTE3.THE PC BOARD GROUND SURFACE.
NOTE4.LOT NUMBER OF CONNECTOR IS INDICATED IN THE VISIBLE AREA.

注1. 本斜線部内にはパターンを配線しないこと。
注2. ランドは基板の両面に設けること。
注3. この部分は基板接地面である。
注4. 図示の位置にロットNo. を表示する。

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 12/JAN/2016		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) RP04	日本航空電子工業株式会社	JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ116710	版数 (VER.) 4
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) RP04R026JA1					
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	N. IKENAGA						
± 0.8	×° ±	査閲 APPD.	—						
× ± 0.4	×°×' ±	承認 APPD.	S. HIRAYAMA	質量 (MASS)					
×× ± 0.1		単位 (UNIT) : mm							
××× ±									